機能性表面処理技術と評価に関する研究(第2報)

宫城友昭*•髙橋芳朗*•園田正樹*•秋本恭喜** *金属担当•**電子•情報担当

Research of Functional Surface Treatments and Evaluating Methods (2nd Report)

*Tomoaki MIYAGI•*Yoshiro TAKAHASHI•*Masaki SONODA•**Yasuki AKIMOTO *Metallurgical Engineering Section **Electronics and Information Engineering Section

要 旨

センターの要素技術として機能性表面処理技術や評価技術を蓄積し、県内企業の技術支援、技術力向上、センターの試験高度化を目指すため、本研究に取り組んだ.表面処理の一手法として光触媒に着目し、スパッタリング法で複合膜を作製および評価することで、弱光環境下での触媒活性の向上を目指している.本年度は、昨年度に確立したTiO2薄膜の評価方法をもとに、TiO2薄膜の光触媒活性を評価するとともに、SiO2薄膜の堆積効果について調べた.その結果、①TiO2薄膜は成膜時の基板温度が高いほど光触媒活性が大きくなること、②TiO2薄膜表面にSiO2薄膜を堆積すると超親水化により光触媒活性が向上することが分かった.

1. はじめに

材料の表面に膜を塗布したり,電気的または化学的に めっきを施したり,蒸着や熱処理を行うことで,母材に はない機能を付加させる機能性表面処理技術への期待は 大きい.近年 IoT や EV 車などが注目を浴び,電子デバイ スの重要性がより高まっていることもあり,表面処理技 術とその評価技術を向上させることは必要不可欠となっ ている.大分県には自動車や半導体,医療をはじめ様々 な分野の産業が集積しているが,製品の表面処理やその 評価に関する技術相談は多く,かつ内容も多岐に渡って いる.

一方,防汚・抗菌作用を持つ光触媒技術は,建材に利 用されているだけでなく,半導体や食品,医療機器メー カが抱える技術的課題¹⁾の解決に応用が期待されてい る.しかし,基材への均一な薄膜作製や弱光環境下での 触媒活性が課題となっている¹⁾.そこで,スパッタリン グ法による光触媒複合膜の作製および評価により,シー ズ技術を構築して課題解決を目指すとともに,得られた 技術や知見を県内企業の技術支援や技術力向上,センタ ーの試験高度化に広く活用することを目的として本研究 に取り組んでいる.本年度は,スパッタリング法によっ てガラス基板上にTiO₂薄膜およびSiO₂薄膜を作製し,光 学特性や結晶性,表面観察を行ったほか,メチレンブル ー溶液を用いた光触媒活性の評価を行った.これに加え て,各薄膜のデータをもとにTiO₂薄膜へのSiO₂薄膜の堆 積効果を調べたので,以下に報告する.

2. 実験方法

2.1 基板

各薄膜を作製する基板として、ホウケイ酸ガラス 7059(ガラス基板:φ2inch×t1mm)を用いた.ブロワーで 表面の付着物を除去して、実験に供した.

2.2 スパッタリング装置

スパッタリング装置として、アルバック社製ヘリコンスパッタ MUE-201C-HC3 を使用した.装置全体の写真を Fig.1 に示 す.成膜室には RF カソードが 3 個あり、試料ホルダーは それらの上方にセットする.また、チャンバー外部より アルゴンガスや酸素ガスを導入できるようになってい る.ガス流量はマスフローメータで調整する.



Fig.1 スパッタリング装置

2.3 成膜条件

スパッタリング装置で成膜する時の各パラメータを

Table 1 に示す.

	TiO_2	SiO_2
チャンバ	0.1 Pa	0.1 Pa
一圧力		
スパッタ	Arのみ	Arのみ
ガス		
ターゲッ		
ト―試料	150 mm	150 mm
間の距離		
RF 電力	100 W	100 W
基板温度	室温,100、	室温,300℃
	200, 300°C	

Table 1 成膜条件

2.4 分光光度計による光学特性評価

分光光度計(島津製作所 SolidSpec-3700)を使用して, 作製した薄膜の光学特性(透過率および反射率)を測定し た.また,この装置には膜厚計測ソフトウェアが付属し ており,これにより膜厚測定も行った.干渉波形の山と 谷の波長より,試料の屈折率および入射角を既知の値と して代入し,膜厚を計算するものである.

2.5 X線回折による結晶構造解析

100nm 以下の薄膜や微小部解析も可能な X 線回折装置 (リガク Smartlab)を使用して,作製した薄膜の結晶構造 や結晶性を調べた.

2.6 レーザー顕微鏡による表面粗さ測定

レーザー顕微鏡(キーエンス VK-9700)を使用して,作 製した薄膜の表面粗さ(算術平均粗さ Ra)を測定した.

2.7 メチレンブルー溶液による光触媒活性の評価

作製した薄膜の光触媒活性を評価するために,25μ mol/L に希釈した 15mL のメチレンブルー溶液を用意し た.この中に試料を浸し,紫外線照射ランプ(中心波長: 365nm)で紫外線を照射して,1,2,3 および 6 時間経過後 のメチレンブルー溶液を採取した.そして分光光度計で 吸光度を測定し,初期のメチレンブルー溶液の濃度と吸 光度の比から各経過時間後の濃度を算出して濃度 - 時間 プロットを作成し,その減少度合いや傾きから各試料の 光触媒活性を評価した.

実験結果および考察

3.1 TiO2薄膜の作製および光触媒活性などの評価

Table 1の条件で TiO2薄膜をスパッタリング法によっ

て作製し,結晶構造・結晶性や膜厚が光触媒活性にどう 影響するかを調べた.

Fig.2に、ガラス基板上に基板温度を変化させて作製 した TiO₂薄膜の光触媒活性評価結果を示す.ただし、膜 厚はいずれも 400nm とする.これより、基板温度が高く なるほど、光触媒活性が高くなることが分かった.200℃ および 300℃では、UV 照射時間が経つほどメチレンブル 一溶液の濃度もほぼ線形に減少している.一方、100℃で は 6 時間経過後にわずかに光触媒活性が見られるもの の、室温ではほとんど見られなかった.

Fig.3に、ガラス基板上に基板温度を変化させて作製 した TiO₂薄膜の X 線回折結果を示す. ただし, 膜厚はい ずれも 400nm とする. これより, 室温ではアモルファス であるが,100℃で27°付近にルチル型TiO2の(101)面の ピークが現れ, 200℃でルチル型 TiO2の(101) 面のピーク が大きくなるとともに、25°付近にアナターゼ型 TiO2の (101) 面のピークが現れ始めていることが分かった. さら に、300℃では 37°付近にルチル型 TiO2の(200)面のピー クと、38°付近にアナターゼ型 TiO₂の(112)面のピーク も現れ始めた.これより,基板温度が高くなるほど結晶 性が向上し,ルチル型 TiO2 とアナターゼ型 TiO2 が生成す ることが分かった²⁾. 昨年度の研究³⁾では室温で TiO₂薄 膜を作製した後に 300℃で加熱して結晶化させていた が、今回のように加熱しながら成膜することで、結晶性 の良い TiO2 薄膜が作製できることが分かった. これらを 総合すると、アナターゼ型 TiO2の結晶性が良い時ほど、 光触媒活性は大きいことが分かった. ルチル型 TiO2 とア ナターゼ型 TiO₂のバンドギャップはそれぞれ 3.2eV, 2.8eV であり、アナターゼ型 TiO2の方が電子が価電子帯 から伝導帯へ励起するのに必要な光エネルギーは小さい ⁴⁾. それ故に, ルチル型 TiO₂のピークのみ現れた 100℃ の試料に比べて、アナターゼ型 TiO2のピークが明瞭に現 れた 200℃および 300℃の試料では高い光触媒活性が見 られたと考えられる.



Fig.2 ガラス基板上に基板温度を変化させて作製した
 Ti02薄膜の光触媒活性評価結果(膜厚:400nm)



Fig.3 ガラス基板上に基板温度を変化させて作製したTiO₂薄膜のX線回折結果(膜厚:400nm)

Fig. 4 および Fig. 5 に, 基板温度 300℃において, ガラ ス基板上に膜厚を変化させて作製した TiO₂ 薄膜の光触 媒活性評価結果と X 線回折結果を示す. X 線回折結果か ら, 膜厚が大きくなるほどピークが大きくなり, 隠れて いたアナターゼ型 TiO₂ の (211) 面やルチル型 TiO₂ の (300) 面のピークも, 54°と 55°付近に現れ始めている ことが分かった. そして, 膜厚が大きくなるほど, 光触 媒活性も向上することが分かった.

Table 2 に、ガラス基板上に膜厚を変化させて作製し た TiO2 薄膜の表面粗さの測定結果を示す. これより, 膜 厚が大きくなるほど表面粗さが増加していることが分か った. 光触媒反応は薄膜表面で起こる反応であり、メチ レンブルー分子が TiO2薄膜表面に吸着・分解することで 反応が進む.ここで、Fig.4 を再度見てみると、膜厚が 大きい時ほど、UV 照射して1時間後および2時間後の光 触媒活性は大きいことが分かる.表面粗さが大きいほど 実表面積も大きくなり、メチレンブルー分子が TiO2薄膜 に吸着する数も増加し,一定時間に分解するメチレンブ ルー分子の数も多くなると考えられる. それ故に, UV 照 射して1時間後および2時間後は、表面粗さの増加によ り実表面積が増加したことが、光触媒活性の向上に支配 的に寄与したと考えられる.しかし、6時間後の結果を 見てみると、光触媒反応が全体的に律速になり、また膜 厚 666nm の試料の反応速度が低下し、膜厚 340nm の試料 とメチレンブルー溶液の濃度の差が小さくなっているこ とが分かった.これは、光触媒反応が進んでメチレンブ ルー分子が TiO2表面全体を覆うことで、反応が律速にな ることが理由であると考えられる. すなわち, UV 照射し た直後は TiO2 薄膜表面に吸着しているメチレンブルー 分子の面密度が小さいが,時間が経過すると吸着するメ チレンブルー分子の数も増加し、TiO2薄膜がメチレンブ ルー分子で覆われる.したがって,新たなメチレンブル ー分子が表面に到達しても,先に吸着したメチレンブル ー分子が分解してから吸着する過程を辿るため,反応速 度が低下して律速になる.その結果,340nmと666nmの 試料の6時間後のメチレンブルー濃度の差が小さくなっ たと考えられる.



Fig.4 ガラス基板上に膜厚を変化させて作製した Ti0₂薄膜の光触媒活性評価結果 (基板温度:300℃)



Fig.5 ガラス基板上に膜厚を変化させて作製した Ti0₂ 薄膜の X 線回折結果(基板温度:300℃)

Table 2 TiO₂薄膜の膜厚と表面粗さの関係

膜厚(nm)	表面粗さ Ra(µm)
基板のみ	0.005
182	0.006
340	0.010
666	0.021

3.2 SiO₂薄膜の作製および光触媒活性などの評価

Fig.6に, Table 1の条件でガラス基板上に基板温度を

変化させて作製した SiO₂薄膜の X 線回折結果を示す. こ れより, 基板を 300℃に加熱して作製した場合でもピー クは現れておらず, アモルファス状態であることが分か った.

Fig.7に,Si(001)ウェハ上に作製したSi02薄膜の膜厚 と成膜時間の関係を示す.今回の実験では,薄膜作製用 の基板にホウケイ酸ガラス7059を使用しており,この主 成分が同材料のSi02であるため,分光光度計の膜厚計測 ソフトでは測定できなかった.そこで,膜厚測定専用の 基板としてSi(001)ウェハを使用し,その上にSi02薄膜 を作製して、膜厚を測定した.その結果,成膜時間を増 加させると膜厚もほぼ線形に増加していることが分か り,この傾きから成膜速度を計算したところ,117.3nm/h であることが分かった.

Table 3 に, Si (001) ウェハ上に膜厚を変化させて作製 した SiO₂薄膜の表面粗さの測定結果を示す.これより, TiO₂薄膜と同様に, 膜厚が大きくなるほど表面粗さが増 加していることが分かった.

Fig.8 に,ガラス基板上に基板温度を変化させて作製 した Si0₂薄膜の光触媒活性評価結果を示す.これより, UV 照射を6時間行った後でもメチレンブルー溶液の濃 度は全く減少しなかったことから,基板温度が室温およ び 300℃のいずれの温度で作製したとしても,Si0₂薄膜 は光触媒活性を示さないことが分かった.



Fig.6 ガラス基板上に基板温度を変化させて作製した Si0₂薄膜のX線回折結果



Fig.7 Si(001)ウェハ上に作製した SiO₂ 薄膜の膜厚 と成膜時間の関係

Table 3 SiO₂薄膜の膜厚と表面粗さの関係

膜厚(nm)	表面粗さ Ra(µm)
基板のみ	0.005
279	0.011
757	0.027
1179	0.046



Fig.8 ガラス基板上に基板温度を変化させて作製した Si0₂薄膜の光触媒活性評価結果

3.3 Ti0₂ と Si0₂ の 2 層膜の作製および光触媒活性の 評価

Fig.9 に, Si0₂の持つ超親水性が光触媒活性の向上に どのように寄与するかを調べた結果を示す.まず基板温 度を 300℃にして TiO₂薄膜を作製し,その上に SiO₂薄膜 を室温で 100nm 毎に堆積していきながら徐々に SiO₂薄膜 を厚くして,その都度光触媒活性について評価した.TiO₂ 薄膜のみの場合と比較すると,SiO₂薄膜を 100nm,200nm と堆積した場合では,光触媒活性が向上していることが 分かった.ただし,200nm 堆積したときの光触媒活性は 100nm 堆積した時よりも低下しており,100nm 堆積した時 に光触媒活性が最大になることが分かった.さらに,SiO₂ 薄膜のみの場合よりも劣っていることが分かった.

Table 4 に、堆積させた Si0₂薄膜の膜厚と表面粗さを 示す.これより、堆積する前の TiO₂ 薄膜の表面粗さが 0.008 µmに対して SiO₂薄膜を堆積することで、表面粗さ が増加していることが分かった.これらの結果から、SiO₂ 薄膜の持つ超親水性によりメチレンブルー溶液の接触面 積が増加し、さらに表面粗さが増加することで実表面積 が増加したため、光触媒活性が向上したと考えられる⁵⁾. しかし、SiO₂薄膜の膜厚が厚くなると、光触媒活性を持 つ TiO₂薄膜が徐々に覆われていくことで、光触媒活性が 低下していくと考えられる.



Fig.9 TiO₂薄膜上にSiO₂薄膜を堆積した時の光触媒 活性評価結果

 Table 4 TiO2 薄膜上に堆積した SiO2 薄膜の膜厚と表面

 粗さの関係(TiO2 薄膜の膜厚: 340nm)

堆積した SiO ₂ 薄膜	表面粗さ Ra(µm)
の膜厚(nm)	
TiO ₂ のみ	0.008
100	0.013
200	0.019
400	0.030

4. まとめ

センターの要素技術として機能性表面処理技術や評価 技術を蓄積し,県内企業の技術支援,技術力向上,セン ターの試験高度化を目指すため,本研究に取り組んだ. 表面処理の一手法として光触媒に着目し,スパッタリン グ法で複合膜を作製および評価することで,弱光環境下 での触媒活性の向上を目指している.本年度は,昨年度 に確立した TiO₂薄膜の評価方法をもとに,TiO₂薄膜の光 触媒活性を評価するとともに,SiO₂薄膜の堆積効果につ いて調べた.

(1)TiO2薄膜の作製および光触媒活性などの評価

- ・基板温度が高くなるほど、アナターゼ型 TiO₂の結晶性 が向上し、光触媒活性が向上することが分かった.
- ・膜厚が大きくなると表面粗さが増加して、実表面積が 増加することで光触媒活性が向上することが分かっ た.
- (2)Si02薄膜の作製および光触媒活性などの評価
- ・基板温度は室温および 300℃の場合,いずれもアモル ファス状態であることが分かった.また,Si(001)ウェ ハ上への成膜速度は 117.3nm/h であることが分かっ

た.

・基板温度が室温および 300℃のいずれの時も,光触媒 活性を示さなかった.

(3) TiO₂とSiO₂の2層膜の作製および光触媒活性の評価

 Ti02薄膜上にSi02薄膜を堆積したところ、表面が超親 水性になり、光触媒活性が向上し、100nm 堆積すると 最大になった.しかし、さらに200nm、400nm 堆積する と、光触媒活性は低下し、400nm ではTi02薄膜より劣 ることが分かった.

参考文献

- 1)橋本和仁,藤嶋昭:図解光触媒のすべて、オーム社、 p75-77
- 2) A.S Bakri, M.Z Sahdan, F Adriyanto, N.A. Raship, N.D.M Said, S.A Abdullah, M.S Rahim :Effect of Annealing Temperature of Titanium Dioxide Thin Films on Structual and Electrical Properties, ICESNANO (2016), p030030-4
- 3)宮城友昭,高橋芳朗,園田正樹,秋本恭喜:機能性表 面処理技術および評価に関する研究,平成29年度大分 県産業科学技術センター研究報告,p22-26
- 4)早川亮,芦澤里樹,佐藤貴裕,古屋雅章,長田和真: 光触媒を利用した水素製造技術に関する研究,山梨県 工業技術センター平成 29 年度研究報告, p74
- 5) 高林外広: 反応性スパッタリング法による低反射光触 媒媒膜の低温生成, まてりあ第24巻第9号(2003), p668